中信证券股份有限公司
关于上海艾为电子技术股份有限公司
2021 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“艾为电子”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，负责艾为电子上市后的持续督导工作，并出具 2021 年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并已报上海证券交易所备案。本持续督导期间，未发生协议内容做出修改或终止协议的情况。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2021 年度，艾为电子未发生需公开发表声明的违法违规事项。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等。	2021 年度，艾为电子及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职	2021 年度，保荐机构通过日常沟通、

序号	工作内容	实施情况
	调查等方式开展持续督导工作。	定期或不定期回访、现场检查、尽职调查等方式，对上市公司开展持续督导工作。其中，保荐机构于 2022 年 1 月 10 日对上市公司进行了现场检查。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	保荐机构持续督促、指导上市公司及其董事、监事、高级管理人员，本持续督导期间，上市公司及其董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求，并切实履行其所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	保荐机构督促艾为电子依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	保荐机构对艾为电子的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，艾为电子的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	保荐机构督促艾为电子严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对艾为电子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	保荐机构对艾为电子的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	实施情况
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所监管措施或纪律处分的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2021 年度，艾为电子或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况。
13	关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，保荐人应及时向上海证券交易所报告。上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	2021 年度，艾为电子及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2021 年度，艾为电子未出现该等事项。
15	在持续督导期间发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。	2021 年度，艾为电子及相关主体未出现该等事项。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、技术迭代风险

公司下游为以智能手机为代表的新智能硬件领域，终端客户产品更新换代较快，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断升级现有产品并研发新产品，从而保持技术先进性和产品竞争力。公司主要芯片产品的技术迭代周期一般为 3 年左右，公司各类芯片产品的迭代周期一般为 12 个月左右，以智能手机为代表的新智能硬件通常每 1-2 年会进行更新换代，但是公司的芯片产品非新智能硬件中的主芯片且为通用性芯片，公司在持续进行产品迭代的同时，通常相关芯片的技术迭代周期会长于新智能硬件本身的迭代周期。

由于公司下游终端客户多为知名品牌客户，其产品系列齐全，对公司产品型号有相对长期的使用需求，因此，公司大部分主要型号产品在上市后拥有 5 年以上的生命周期。如果公司不能根据行业及客户需求保持较快的技术迭代和技术迭代，不能保持持续的创新能力及贴紧下游应用的发展方向，并持续推出具有竞争力的新产品，将导致公司市场竞争力下降，并给公司未来业务拓展和经营业绩带来不利影响。

（二）经营风险

1、公司产品为通用型芯片，下游应用集中于智能手机领域，受下游智能手机出货量影响较大的风险

公司的芯片产品为通用型芯片，下游应用集中于智能手机市场，同时可应用于可穿戴设备、智能便携设备、物联网设备等领域。公司主要终端客户为荣耀、小米、OPPO、vivo、传音等知名手机品牌客户，以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商。2021 年度，公司对上述五家手机厂商的收入占比分别为 43.05%，比上期下降 8.11%；对上述三家 ODM 厂商的收入占比为 18.22%，比上期下降 8.65%。

报告期内，经估算公司产品在智能手机市场的收入占比超过 75%，收入较为

集中，全球智能手机市场的景气程度和出货量会影响智能手机品牌客户对公司芯片的使用需求。若未来智能手机市场需求萎缩造成智能手机出货量下降，将对公司未来盈利能力产生不利影响。

2、市场竞争风险

集成电路行业受国家政策鼓励且发展迅速，行业内企业逐渐增多。一方面，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行市场拓展，另一方面，新进入厂商也不断抢夺市场份额，市场竞争逐渐加剧。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，不能根据客户需求及时进行技术和产品创新，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

此外，相较于公司 800 余种芯片产品型号，同行业集成电路国际巨头，如 TI 和 ADI，拥有上万种芯片产品型号，涵盖了下游大部分应用领域。一旦国际巨头企业采取强势的市场竞争策略与公司同类产品进行竞争，将会对公司造成较大的竞争压力，如公司不能实施有效的应对措施，及时弥补竞争劣势，将对公司的竞争地位、市场份额和经营业绩造成不利影响。

3、半导体行业需求增长导致晶圆及封测价格上涨的风险

公司为 fabless 运营模式下的芯片设计公司，对外采购的主要内容包括晶圆和封测，近年来随着半导体产业链国产化进程加快和国际产业链格局的变化，国内半导体行业的晶圆和封测需求快速上升，晶圆和封测产能逐步趋紧，采购价格整体呈上涨趋势。公司已通过加快产品迭代、选择先进生产工艺、自建测试中心等方式应对上游价格的上涨，未来如果上游产能紧张的形式加剧，或公司不能有效地应对采购价格上涨的影响，则将对公司的经营业绩产生不利影响。

4、规模扩张导致的管理风险

公司规模扩张带来的管理风险报告期内，公司的业务规模进一步扩大。随着公司业务的发展及募集资金投资项目的实施，公司收入规模和资产规模将会持续扩张，相应将在资源整合、市场开拓、产品研发、质量管理、内部控制等方面对管理人员提出更高的要求。如果公司内控体系和管理水平不能适应公司规模的快速扩张，那么公司可能发生规模扩张导致的管理和内部控制风险。

5、募集资金投资项目实施风险

公司募投项目模拟集成电路产品开发与产业化项目、研发中心建设项目正在逐步实施。如果未来行业竞争加剧、市场发生重大变化，或研发过程中关键技术未能突破、未来市场的发展方向偏离公司的预期，致使研发出的产品未能得到市场认可，产品营销网络开拓不利，则公司募投项目的实施将面临不能按期完成或不能达到预期收益的实施风险，对公司业绩产生不利影响。此外，上述募集资金投资项目实施后，公司预计将陆续新增固定资产投资，导致相应的折旧增加。如果因市场环境等因素发生变化，募集资金投资项目投产后盈利水平不及预期，新增的固定资产折旧将对公司的经营业绩产生不利影响。

（三）财务风险

1、公司业绩持续增长存在不确定性风险

报告期内，实现营业收入 232,700.14 万元，较上年同期增长 61.86%；实现归属于母公司所有者的净利润 28,834.91 万元，较上年同期增长 183.56%；剔除股份支付费用影响后，归属于上市公司股东的净利润为 32,165.98 万元，同比增长 216.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 24,673.16 万元，较上年同期增长 175.04%；研发费用投入 41,672.52 万元，较上年同期增长 102.91%，研发费用占收入比例增长 3.62%。

公司收入及净利润的持续增长主要系受下游需求增长、进口替代等因素影响，同时公司加强研发投入使得产品型号及销售规模逐渐增加。为增强公司的技术优势及产品竞争力，近年来公司不断增加研发投入，扩充人员规模，并加大在研发场所、研发测试设备等方面的固定资产投入。报告期内，公司的研发费用、人员规模、固定资产规模均呈现较快的增长态势。如果未来公司下游无法保持持续增长，公司无法保持在技术、产品及市场方面的竞争优势，或者公司未能妥善处理快速发展过程中的经营问题，公司将面临收入无法保持持续快速增长，或因成本费用大幅上升进而导致净利润无法持续增长的风险。

2、毛利率波动风险

报告期内，公司各类产品毛利率及综合毛利率均存在一定程度的波动。公司

产品主要应用于以智能手机为代表的新智能硬件，产品毛利率水平主要受市场供求关系、产品技术先进性、产品更新迭代、公司销售及市场策略等因素综合影响。新产品推出时，为快速打开市场，毛利率水平可能相对较低，随着产品的迭代升级，毛利率水平会有所上升；受市场竞争影响，产品毛利率可能有所下滑；公司产品型号达 800 余款，不同型号产品销售结构的变化亦会对各类产品毛利率造成影响。由于公司各产品面临的市场竞争环境存在差异，各产品所在的生命周期阶段及更新迭代进度不同，产品的销售结构不同，公司存在因上述因素导致的毛利率波动风险。若公司未能根据市场变化及时进行产品技术升级，产品技术缺乏先进性，或公司市场推广未达预期造成高毛利产品销售占比下降，可能导致公司毛利率水平出现波动，进而对公司经营业绩产生不利影响。

3、存货规模较大及跌价风险

公司存货主要由原材料、委托加工物资、库存商品和在途物资构成。本报告期末，公司存货账面价值为 48,156.22 万元，较 2020 年存货增长 27.19%，存货账面价值增幅较大；公司根据存货的可变现净值低于成本的金额计提相应的跌价准备，2021 年年末公司存货跌价准备余额 2,799.68 万元；若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新导致存货产品滞销、存货积压，将导致公司存货跌价风险增加，对公司的盈利能力产生不利影响。

4、汇率波动风险

因公司的海外业务通常以美元进行计价并结算，香港艾唯记账本位币为美元，同时公司存在较多的境内外母子公司关联交易，汇率波动将会对公司汇兑损益及其他综合收益——外币报表折算差造成影响。报告期内，公司汇兑损益金额为 76.94 万元，主要系外币交易过程中产生的已实现汇兑损益和期末持有的外币资产负债因汇率变动产生的未实现汇兑损益；报告期内，公司其他综合收益——外币报表折算差金额为 2,332.87 万元，主要系香港艾唯的外币报表折算差及母子公司之间关联交易产生的汇率折算差。如果未来汇率出现大幅波动或者我国汇率政策发生重大变化，将造成公司经营业绩及所有者权益的波动。

（四）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦风险

伴随全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，也对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。

集成电路是高度全球化的产业，如果国际贸易摩擦加剧，在销售端，公司终端客户可能会因为贸易摩擦受到不利影响，进而影响到公司向其销售各类产品，导致对公司的经营业绩产生一定不利影响；在采购端，公司主要晶圆供应商、EDA 软件供应商可能受到国际贸易政策的影响，进而影响其对公司的晶圆及 EDA 软件的供应，导致对公司采购产生一定不利影响。

2、新型冠状病毒肺炎疫情风险

新冠肺炎风险新型冠状病毒肺炎自爆发以来，对全球的复工复产、物流周期等造成了不利影响。目前，疫情尚未结束，未来仍可能对公司所处行业上下游产生一定影响，进而影响公司经营业绩。

四、重大违规事项

2021 年度，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2021 年度，公司主要财务数据及指标如下所示：

单位：元

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	2,327,001,356.81	1,437,663,669.46	61.86
归属于上市公司股东的净利润	288,349,084.62	101,689,549.02	183.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	246,731,565.74	89,708,925.61	175.04
经营活动产生的现金流量净额	286,483,564.28	199,930,714.48	43.29
主要会计数据	**2021 年末**	**2020 年末**	**本期末比上年同期末增减（%）**
归属于上市公司股东的净资产	3,727,893,055.52	380,552,127.51	879.60

总资产	4,452,471,290.46	1,053,227,730.24	322.75
主要财务指标	**2021 年**	**2020 年**	**本期比上年同期增减（%）**
基本每股收益（元 / 股）	2.09	0.82	154.88
稀释每股收益（元 / 股）	2.09	0.82	154.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	1.79	0.72	148.61
加权平均净资产收益率（%）	18.76	29.22	减少10.46个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	16.05	25.77	减少9.72个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	17.91	14.29	增加3.62个百分点

1、2021 年度营业收入增长 61.86%，主要系公司 2021 年度持续拓展市场，终端客户需求增长及新产品的开拓，从而业务规模增加所致；

2、2021 年度归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长 183.56%、175.04%，主要系公司收入、利润总额增长较大，以及公司为重点集成电路企业，享受税收优惠及研发费用加计扣除优惠政策所致；

3、2021 年度经营活动产生的现金流量净额增长 43.29%，主要系收入、净利润的增长影响；

4、2021 年基本每股收益、稀释每股收益增长 154.88%、扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 148.61%，主要系报告期营业收入大幅上升，净利润增加、盈利能力提升所致；

5、加权平均净资产收益率减少 10.46%、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少 9.72%，主要系公司在 2021 年首次发行股票后净资产增加所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）公司的核心竞争力

1、领先的核心技术优势

（1）技术积累丰富，具备持续创新能力

公司技术、客户、供应链、人才等多项优势紧密结合、发展迅猛。技术方面，公司积累了大量模拟芯片设计开发经验，截至 2021 年底，公司及控股子公司累计取得发明专利 133 个，实用新型专利 171 个，外观设计专利 2 个，软件著作权 9 个，集成电路布图登记 524 个。

（2）产品领域延伸性强，响应国产化替代需求

公司秉持现代化的集成电路工艺和设计理念，在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。公司在数模混合信号、模拟和射频芯片领域深耕多年，紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新。公司从音频功放芯片和电源管理芯片产品出发，陆续拓展开发射频前端芯片和马达驱动芯片等产品，各类产品技术持续发展，形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力，积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

（3）细分市场具备较强的产品和技术优势

公司主要产品包括音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，在各个细分市场中均具备自身独特的竞争优势。公司在音频功放芯片领域形成了丰富的技术积累和完整的产品系列，发展出集硬件芯片和软件算法为一体的音频解决方案；在电源管理和射频前端芯片领域持续扩充产品种类，并在下游应用市场持续进行拓展；在马达驱动芯片领域较早地进行了技术研发及积累，在国内企业中具有较强的先发竞争优势。

2、人才团队优势

集成电路设计属于智力密集型行业，人才是集成电路设计企业的最关键要素。公司高度重视研发和管理人才的培养，积极引进国内外高端技术人才，目前已建立了成熟稳定的研发和管理团队。截至 2021 年 12 月 31 日，公司共有技术人员 764 人，占全部员工人数的比重达 77.56%，主要研发和技术人员平均拥有十年以上的工作经验；共有核心技术人员 5 人，领导并组建了由多名集成电路设计行业资深人员组成的技术专家团队，构成公司研发的中坚力量。

公司重视人才体系建设，在人才激励、职业通道、薪酬体系、干部体系等系

统级建设方面起步较早，具备一定领先性。公司制定了管理人才定级定岗政策、技术职位体系建设等系列人才培养政策，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，加速人才体系化建设，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源，实现人力资源的合理配置与科学化管理，打造支撑公司长期发展的组织能力和人才梯队，全面提升企业竞争力。此外，公司优质的人才保障制度和文化氛围，不断增强创新人才吸引力和凝聚度，支撑公司持续创新。

3、产品市场优势

公司产品主要应用于以智能手机为代表的新智能硬件领域。通过在手机领域多年的积累，公司在手机端拥有丰富且齐全的产品系列，主要产品涵盖音频功放芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、马达驱动芯片等，产品型号约 800 余款。公司开发的音频功放芯片、背光驱动、呼吸灯驱动、闪光灯驱动、过压保护、GPS 低噪声放大器、FM 低噪声放大器、线性马达驱动等多个产品在智能手机的市场得到广泛认可，并用于知名手机厂商的高端或旗舰机型。公司研发的多款产品在半导体领域获得不同奖项。

4、客户资源优势

公司拥有丰富的客户资源，已纳入众多知名品牌客户的合格供应商名录。公司产品以智能手机为代表的新智能硬件为应用核心，通过突出的研发能力、可靠的产品质量和细致的客户服务，覆盖了包括三星、小米、OPPO、vivo、传音、TCL、联想等知名手机厂商，以及华勤、闻泰科技、龙旗科技等知名 ODM 厂商；在可穿戴设备、智能便携设备和物联网设备等细分领域，持续拓展了细分领域知名企业。

（二）核心竞争力变化情况

2021 年全年，公司的核心竞争力未发生重大变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出变化

2021 年，公司坚持做好主营业务，持续保持有质量发展，在已销的产品稳步增长的前提下，加强研发投入，业务保持稳定增长。2021 年度，公司研发费

用为 41,672.52 万元，研发投入金额较上年同期增长 102.91%。

（二）研发进展情况

2021 年度，公司进一步加强创新能力建设和研发投入，新增申请发明专利 118 个、申请实用新型专利 8 个、申请软件著作权 5 个。截至 2021 年 12 月 31 日，公司在研项目 27 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下：

单位：元

明细	金额
1.募集资金账户资金的增加项：	
（1）本期收到募集资金净额	3,050,985,204.94
（2）专户利息收入	5,594,939.69
（3）理财投资收益	6,576,854.47
（4）通知存款利息	5,437,940.56
小计	**3,068,594,939.66**
2.募集资金账户资金的减少项：	
（1）置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	264,114,957.31
（2）直接投入募集资金投资项目的资金	168,062,270.79
（3）暂时补充流动资金	780,000,000.00
（4）购买理财产品	995,000,000.00
（5）购买通知存款	95,000,000.00
（6）支付发行费用	17,999,188.69
（7）支付专户手续费支出等	4,839.79
小计	**2,320,181,256.58**
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	**748,413,683.08**

截至 2021 年 12 月 31 日，艾为电子募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引

第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的情况如下：

序号	姓名	任职情况	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
1	孙洪军	董事长、总经理、核心技术人员、控股股东、实际控制人	直接持股 69,560,997 股，并持有上海艾准 0.12%的出资份额、上海集为 0.02%的出资份额。	无减持	无质押或冻结
2	郭辉	董事、副总经理、核心技术人员	直接持股 16,200,000 股，直接持有上海艾准 0.10%的出资份额、上海集为 99.98%的出资份额。此外，通过中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 26.58%的份额。	无减持	无质押或冻结
3	程剑涛	董事、核心技术人员	直接持股 6,534,000 股。此外，通过中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 14.18%的份额。	无减持	质押 2,300,000 股股份，无股份冻结
4	张忠	核心技术人员	直接持股 5,400,000 股。此外，通过中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 4.05%的份额。	无减持	质押 700,000 股股份，无股份冻结
5	娄声波	董事、副总经理	直接持股 5,086,800 股。此外，通过中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 28.36%的份额。	无减持	质押 4,500,000 股股份，无股份冻结
6	杜黎明	副总经理、核心技术人员	直接持股 3,458,700 股。此外，通过中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与科创板 IPO 配售，持有集合资产管理计划 20.26%的份额。	无减持	质押 3,200,000 股股份，无股份冻结
7	杨婷	副总经理	直接持股 248,400 股，并持有上海艾准 1.37%的出资份额。	无减持	无质押或冻结
8	史艳	财务总监	持有上海艾准 1.32%的出资份额。	无减持	无质押或冻结

序号	姓名	任职情况	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
9	吴绍夫	监事	直接持股 678,750 股，并持有上海艾准 3.63%的出资份额。	无减持	无质押或冻结
10	林素芳	监事	持有上海艾准 2.69%的出资份额。	无减持	无质押或冻结
11	管少钧	监事	持有上海艾准 3.95%的出资份额。	无减持	无质押或冻结

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，上海艾准直接持有公司股份 10,251,003 股，中信证券艾为电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划直接持有 3,206,000 股。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，上海集为持有上海艾准 37.86%的出资份额。

十一、保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海艾为电子技术股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

彭捷　　王彬

彭　捷　　王　彬

中信证券股份有限公司

2022 年 4 月 14 日